

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ  
СИСТЕМЕ МОНООКИСЬ КРЕМНИЯ-АЛЮМИНИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

А.Е.Гершинский, В.В.Коняшким, А.А.Хороменко, Е.И.Черепов

Основным недостатком методов исследования диффузии в тонких пленках [1-3] является практически полное отсутствие контроля протекающих в них диффузионных процессов. В настоящей работе для изучения диффузии примеси в пленках золупроводника и диэлектрика предлагается электрохимический метод, аналогичный применяемому для изучения диффузии в тонкопленочных системах металл-металл [4]. Электрохимический метод позволяет определить состав исследуемого тонкого слоя и количество вещества в каждой из фаз, образовавшихся в результате диффузии. Он заключается в измерении количества электричества, необходимого для окисления каждой фазы. Установив напряжение на электрохимической системе: электролитическая ячейка - сопротивление ограничения, - следят за продвижением фронта окисления (растворения) через исследуемую тонкопленочную систему, при этом регистрируется изменение тока во времени. Перегиб в токовременной характеристике позволяет зафиксировать переход фронта окисления через границу двух фаз и определить количество электричества, необходимое для окисления вещества фазы.

Методика эксперимента. Исследуемая система изготавливалась последовательной конденсацией в вакууме

$3 - 5 \cdot 10^{-6}$  тор. в виде двухслойного образца алюминия иmonoокиси кремния на диэлектрические подложки (ситалл, кварц). Температура подложек при осаждении пленок алюминия и monoокиси кремния выбиралась в интервале  $100-150^{\circ}\text{C}$  и  $90-290^{\circ}\text{C}$  соответственно. Конденсация обоих слоев производилась без разгерметизации камеры. Monoокись кремния испарялась из термостатированного испарителя [5] при температуре  $1100^{\circ}\text{C}$ . Толщина пленок алюминия составляла  $3000 \text{ \AA}$ , пленок monoокиси кремния  $2000-2500 \text{ \AA}$ . Методика окисления образцов аналогична описанной в работах [4, 6]. Токовременные кривые, характеризующие движение фронта окисления через исследуемую систему, снимались до и после изотермического отжига образцов. При этом расстояние между участками окисления не превышало 3 мм. Отжиг проводился в вакууме  $10^{-5}$  тор. Окисление велось при постоянном напряжении.

Экспериментальные результаты и их обсуждение. I. Типичные токовременные кривые, полученные при анодном окислении образцов непосредственно после их изготовления, представлены на рис. I, а; температура подложки при осаждении monoокиси кремния составляла: 1 -  $90^{\circ}\text{C}$ ; 2 -  $190^{\circ}\text{C}$ ; 3 -  $280^{\circ}\text{C}$ . Кривые состоят из трех участков. Участок АВ характеризует процесс окисления пленки monoокиси кремния, участок СД - окисление алюминия. Наличие промежуточного участка ВС можно объяснить возникновением новой фазы в процессе осаждения monoокиси кремния на поверхности пленки алюминия. Известно, что при конденсации из молекулярного потока состав сконденсированного слоя зависит от скорости диффузионных процессов, протекающих на границе раздела - подложка - конденсат [7], при этом могут возникать новые фазы вещества, отличающиеся по структуре и физическим свойствам от исходных материалов [8, 9]. Поскольку алюминий химически активнее кремния (известно, что алюминий вытесняет кремний из двуокиси кремния [10]), то диффузия его в monoокись кремния может сопровождаться химической реакцией в твердой фазе, при этом следует ожидать возникновения в диффузионной зоне новых фаз - окиси алюминия и свободного кремния. Обично при прохождении процесса анодного окисления через слой кремния ток практически не изменяется во времени (на рис. I, б кривые окисления: 1 - кремний монокристаллический, 2 - тонкопленочная система кремний-алюминий). При прохождении

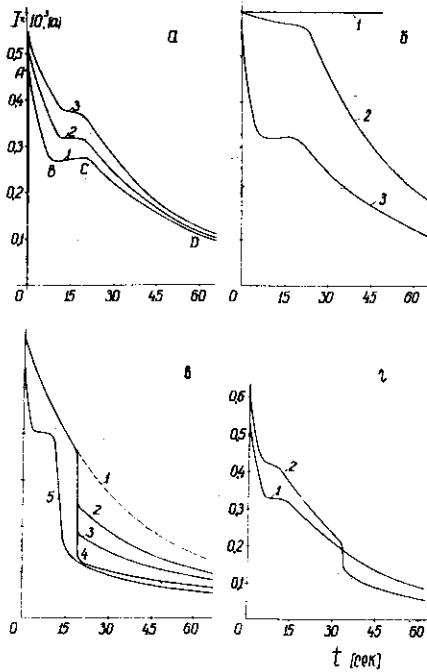


Рис. 1

Вследствие вышесказанного горизонтальные участки ВС на токовременных кривых (рис. I, а) следует приписать окислению свободного кремния, а уменьшение первоначального значения тока - образование окиси алюминия. Для подтверждения данного предположения были приготовлены тонкопленочные системы  $Si-Al$ ;  $SiO-Si-Al$  и  $SiO-Al_2O_3-Al$ . Пленки кремния, алюминия и моноокиси кремния были получены осаждением в вакууме. Окисел алюминия - анодным окислением. На рис. I, б (кривые 2, 3) и рис. I, г (кривая 1) представлены токовременные кривые анодного окисления данных систем соответственно. Горизонтальные участки на этих кривых соответствуют окислению кремния, участки токовременных кривых, предшествующие горизонтальным, - окислению моноокиси кремния, участки, следующие за горизонтальными, - окислению алюминия. По виду кривая 3 рис. I, б и кривая 1 рис. I, г

же процесса анодного окисления через оксид алюминия наблюдается резкий спад тока в токовременных кривых на величину, пропорциональную толщине слоя окиси алюминия (на рис. I, в кривые окисления: 1 - алюминий, 2-4 - тонкопленочная система  $Al-Al_2O_3-Al$ ). При этом если слой окиси алюминия и моноокиси кремния соприкасаются, то в токовременных кривых уменьшается лишь первоначальная величина тока окисления (на рис. I, г кривые окисления: 1 - тонкопленочная система  $SiO-Al_2O_3-Al$ , 2 -  $SiO-Al-Al_2O_3-Al$ ). Если же слой алюминия и моноокиси кремния разделены слоем свободного кремния, резкий спад в величине тока наблюдается при переходе процессом окисления границы раздела кремний-окисел алюминия (кривая 5, рис. I, в).

не отличаются от кривых рис. I, а. Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о том, что при конденсации моноокиси кремния на пленку алюминия выделяется свободный кремний и образуется окись алюминия.

Наличие свободного кремния и соединений  $Al$  с  $O_2$  в тонкопленочной системе  $Al-SiO-Al$  было обнаружено также электронной дифракцией в работе [II] при диффузии алюминия в пленку моноокиси кремния под действием сильного электрического поля.

Из сравнения кривых I (рис. I, г) и 5 (рис. I, в) с кривыми, показанными на рис. I, а, видно, что при осаждении моноокиси кремния на поверхности пленки алюминия слой окиси алюминия и моноокиси кремния соприкасаются, т.е. согласно [12] анионы практически неподвижны, а перенос вещества осуществляется путем диффузии ионов  $Al^+$  и  $Si^+$  через продукты реакции в противоположных направлениях. Ионы алюминия на границе раздела с  $SiO$  вытесняют кремний из моноокиси кремния с образованием окиси алюминия, а ионы кремния осаждаются на границе раздела с алюминием. Преобладает последовательное расположение образовавшихся в процессе конденсации слоев.

2. Для определения основных диффузионных параметров образцы дополнительно подвергались изотермическому отжигу в области температур  $500-650^\circ C$ . Заметные изменения в токовременных кривых наблюдались при температурах отжига выше  $500^\circ C$ . На рис. 2 показаны токовременные кривые анодного окисления тонкопленочной системы моноокись кремния-алюминий, полученные до (кривая 1) и после (кривые 2-6) изотермического отжига образцов при температуре  $600^\circ C$ : в течение 6 мин - кривая 2; 12 мин - кривая 3; 20 мин - 4; 30 мин - 5; 60 мин - 6. В начальной стадии отжига исчезает промежуточная область ВС, а при дальнейшем отжиге на токовременных кривых окисления появляются новые участки  $FG$  и  $GH$ . Исчезновение промежуточной области ВС на токовременных кривых окисления характеризует диффузию кремния, выделившегося при конденсации в пленки алюминия и моноокиси кремния. Возникновение новых участков свидетельствует о дальнейшем росте фаз - окиси алюминия и свободного кремния. Сравнение кривых 2-6 рис. 2 с кривыми I-2 рис. I, г и кривой 5 рис. I, в показывает, что окись алюминия, образующаяся при изотермическом отжиге, в отличие

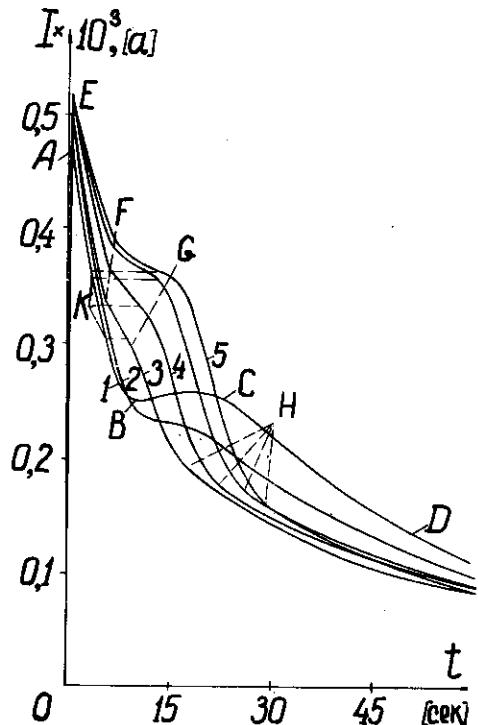


Рис. 2

гласно соотношениям:

$$\text{д} = \alpha_1 Q_1; \quad \text{д}_2 = \beta(I_1 - I_2); \quad \text{д}_3 = \alpha_2 Q_3,$$

где  $Q_1 = \int I(t) dt$  — количество электричества, затраченное на окисление кремния, выделившегося в результате изотермического отжига;  $Q_2 = \int_{I_1}^{I_2} I(t) dt$  — количество электричества, затраченное на окисление моноокиси кремния, прореагировавшей с алюминием в процессе изотермического отжига;  $I_1$  и  $I_2$  (проекции точек  $G$  и  $H$  на ось ординат) — начальное и конечное значения тока при прохождении процесса окисления через слой окиси алюминия. Определение коэффициентов пропорциональности  $\alpha_1$ ;  $\beta$ ;  $\alpha_2$  производилось соответственно на пленках кремния, ме-

от возникающей в процессе конденсации отделена слоем свободного кремния от моноокиси кремния. Такое различие, очевидно, обусловлено концентрационной зависимостью скорости диффузии ионов кремния в рассматриваемой системе из-за ее ограниченного объема.

На рис. 3 показаны кривые увеличения толщины окиси алюминия (кривая 2), выделившегося кремния (кривая 3) и прореагированной с алюминием моноокиси кремния (кривая 1) в зависимости от времени изотермического отжига. Толщины слоев кремния  $d_1$ , окиси алюминия  $d_2$  и моноокиси кремния  $d_3$  определялись из рис. 2 со-

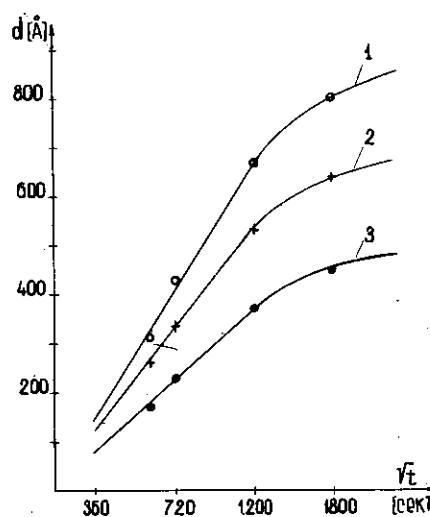


Рис. 3

моноокиси кремния и окиси алюминия известной толщины. Для кремния и моноокиси кремния определялось количество электричества, необходимое для окисления пленки на всю толщину, а для окиси алюминия — разность в значениях начального и конечного токов при процессе анодного окисления рассматриваемой пленки. Определенные таким образом коэффициенты пропорциональности имели значения:

$$\alpha_1 = 1,16 \cdot 10^5 \text{ А/кул};$$

$$\beta = 3,9 \cdot 10^6 \text{ А/а};$$

$$\alpha_2 = 4,13 \cdot 10^5 \text{ А/кул}.$$

Рис. 3 показывает, что изменение толщины образуемых

фаз со временем изотермического отжига подчиняется параболическому закону (прямая в координатах  $d$  от  $\sqrt{t}$ ). При достижении некоторой толщины дальнейший рост практически прекращается, поскольку количество вещества, необходимого для образования фаз в системе, ограничено толщиной сконденсированных слоев. Параболический закон зависимости толщины новых фаз от времени показывает, что лимитирующей стадией в процессе роста фаз является диффузия ионов в объеме образующего вещества [13]. Константы приращения новых фаз, определенные из параболического закона, при температурах отжига  $550^\circ$  и  $600^\circ$  равны  $7,1 \cdot 10^{-15} \text{ см}^2/\text{сек}$  и  $2,24 \cdot 10^{-13} \text{ см}^2/\text{сек}$ , соответственно. Вычисленные отсюда значения энергии активации и предэкспоненциального члена составляют  $4,2 \pm 0,6$  эв и  $4,5 \cdot 10^{-11} \text{ см}^2/\text{сек}$ . Было отмечено, что значение константы приращения толщины новых фаз как при изотермическом отжиге, так и в процессе конденсации существенно зависит от состава остаточной атмосферы при изготовлении образцов.

Увеличение парциального давления кислорода в вакуумной камере приводит к частичному окислению свободного кремния. Причем в процессе окисления может образоваться не только моноокись, но

и другие окислы кремния, что, естественно, изменяет скорость взаимодействия моноокиси кремния с алюминием, как правило, уменьшая её. Повышение же парциального давления паров воды резко увеличивает значение константы приращения толщины новых фаз в процессе конденсации.

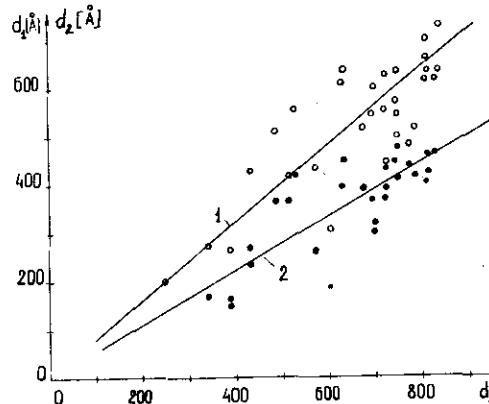
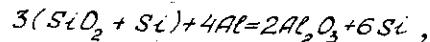


Рис.4

веществ имеют следующие значения:  $d_3/d_1 = 1,8$ ;  $d_3/d_2 = 1,25$ . Если, согласно работам [14,15], моноокись кремния рассматривать как стехиометрическую смесь ( $SiO_2 + Si$ ), а схему взаимодействия алюминия с моноокисью кремния представить равенством



то вычисленные отсюда соотношения толщин образовавшихся и исходных веществ имеют значения, близкие к экспериментальным.

Выше было показано, что при конденсации моноокиси кремния на слое алюминия алюминий диффундирует в моноокись во всем диапазоне рассмотренных температур подложки (90–290°C), в то время, как заметная диффузия при изотермическом отжиге в течение нескольких часов имеет место при температурах выше 500°C. Аналогичные аномальные явления наблюдались в работах [1,8,16] при изучении осаждения одного металла на поверхности тонкого слоя другого. В результате конденсации между слоями металлов образовывались интерметаллические соединения. Температура подложки при этом была значительно ниже температуры, при которой обра-

зуется данное соединение. В работе [1] высокая скорость диффузии в процессе конденсации связывалась с повышенной концентрацией вакансий в конденсирующейся пленке. Причем отмечалось, что ширина диффузионной зоны при конденсации не зависит от толщины пленки. В других работах [8,16] предполагалось, что описанные выше аномалии могут быть связаны с существенным увеличением в процессе конденсации температуры осаждаемой пленки. Известно [17], что при конденсации из молекулярного потока температура осаждаемой пленки существенно превышает температуру подложки и, кроме того, зависит от толщины пленки и температуры подложки.

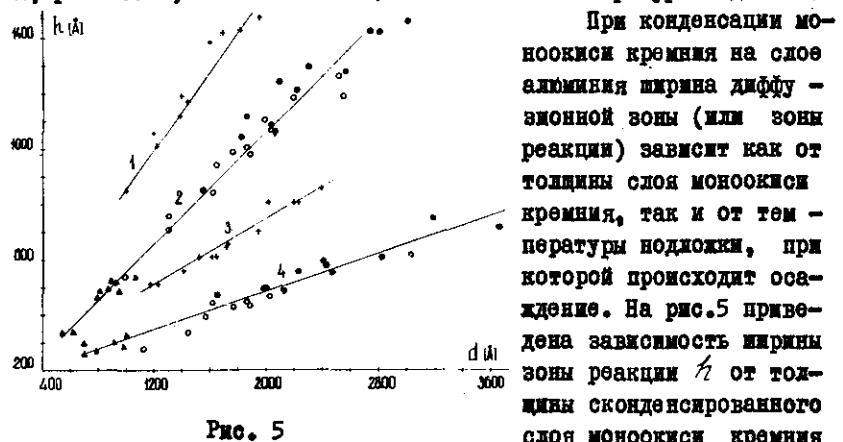


Рис. 5

$d$  при различных температурах подложки  $T_n$ , временах осаждения  $t_k$  и расстояниях от источника пара до подложки  $\ell$ :

1.  $\ell = 12$  см;  $T_n = 280^\circ\text{C}$ ;  $t_k = 240$  сек,
2.  $\ell = 15$  см;  $T_n = 275^\circ\text{C}$ ;  $t_k = \Delta -270$ ,  $\circ -360$ ,  $\bullet -450$  сек,
3.  $\ell = 12$  см;  $T_n = 100^\circ\text{C}$ ;  $t_k = 300$  сек,
4.  $\ell = 15$  см;  $T_n = 180^\circ\text{C}$ ;  $t_k = \Delta -270$ ,  $\circ -360$ ,  $\bullet -450$  сек.

Конденсация моноокиси кремния на тонкий (~300 Å) слой окиси алюминия, покрывающий пленку алюминия, так же как и конденсация на слой алюминия, приводит к возникновению свободного кремния и окиси алюминия (ср. кривые 1 и 2 рис.1,г), т.е. атомы алюминия, находящиеся на границе раздела алюминий–окись алюминия при осаждении моноокиси кремния диффундируют через окисел алюминия и вступают во взаимодействие с моноокисью кремния. Кроме того, при осаждении моноокиси кремния на слой алюминия,

сконденсированный на диэлектрической подложке, диффузия алюминия наблюдалась не только в моноокиси кремния, но и в подложку. Приведенные выше данные могут быть результатом существенного повышения температуры исследуемой системы в процессе осаждения моноокиси кремния по сравнению с температурой подложки.

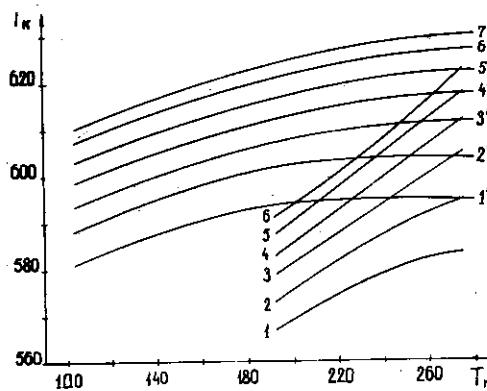


Рис. 6

вательно. Расстояние до подложки II см). Температура осаждаемой пленки оценивалась из температурной зависимости константы приращения толщины новых фаз с использованием полученных выше значений энергии активации и предэкспоненциального члена. Константы приращения фаз вычислялись из параболического закона по ширине зоны реакции (диффузии), приведенной на рис.5. За время реакции принималось время конденсации. Из рис.6 видно, что температура осаждаемой пленки существенно отличается от температуры подложки, что согласуется с результатами работ [16, 17]. Однако следует отметить, что при конденсации моноокиси кремния, которая является хорошим диэлектриком, в области рассмотренных значений наблюдается слабая зависимость температуры конденсата от температуры подложки по сравнению с зависимостью, имеющей место при конденсации металлов [16, 17].

## Л и т е р а т у р а

1. WEAVER C., BROWN L.C. Diffusion in Evaporated Films of Silver-Aluminium - "Phil. Mag.", 1968, vol.17, p.881.
2. SAH C.T., SETILO D.A., TREMEN D.A. Diffusion of phosphorus in silicon oxide film.-"Phis.Chem.Sol.", 1959, vol.11, p.288.
3. БАДАЛОВ А.З., ШУМАН В.Б.. Диффузия  $\text{Al}$  сквозь слой  $\text{SiO}_2$ . "ФТП", 2, 1968, стр. 741.
4. ГЕРШИНСКИЙ А.Е., КОСЦОВ Э.Г. Электрометрический метод определения коэффициентов диффузии примеси в тонких металлических пленках. "ФММ", 30, 1315, 1970.
5. ПЧЕЛКИН В.Ю., СОЛДАТЕНКО И.С., ХОРОМЕНКО А.А. Трубчатый испаритель. "ПТЭ", 1971, 4, 174.
6. ГЕРШИНСКИЙ А.Е. О механизме анодного окисления тонких слоев вентильных металлов. "ФММ", 1971, т.32, вып.2, стр.328.
7. БУЛАМОВ А.С., ВАСЮТИНСКИЙ Б.М., КАРТАЗОВ Г.Н., КОГАН В.С., ЯКИМЕНКО Л.Ф. Труды II семинара по жаростойким покрытиям. "Наука", Л., 1968.
8. PASHLEY D.W. The Nucleation, Growth, Structure and Epitaxy of Thin Surface Films.-"Adv.Phys.", 1965, vol.14, p.327.
9. SHIRAI S., FUKUDA Y., NOMURA M. Structure of Thin Layers of Some E.C.C. Metals Deposited on Oriented Ag, Pd, Ni Films. -"J.Phys.Soc.Japan", 1961, vol.16, p.1989.
10. НОВОХАТСКИЙ И.А., ЕРШОВ Г.С. Кинетика взаимодействия кремнезема с алюминием, углеродом и марганцем, растворенными в расплавленном железе. "МХ", 1967, 61, 1731.
11. PIVOT J., BOUDELLIE M., CACHARD A., DUPPUY. Direct evidence of metal electrode diffusion into dielectric of Al-SiO-Al Capacitors in high electric fields. - "Phys.Stat.Sol.(a)", 1970, vol.2, p.319.
12. JOST W. Diffusion and Chemische Reaction in festen Stoffen. Dresden, 1937, 180 p.
13. ХАУФЕ К. Реакции в твердых телах и на их поверхности. М., ИЛ, 1963, т.2, 192.
14. BRADY E.W. A Study of amorphous  $\text{SiO}_2$ . - "J.Phys. Chem", 1959, vol.63, p.1149.
15. BENYON J. Silicon Monoxide: Fact or Fiction.- "Vacuum", 1970, vol.20, p.293.
16. ГЕРШИНСКИЙ А.Е., КОЛОСАНОВ В.А. О диффузии при конденсации металлов в вакууме. "ФММ", 1971, 32, 1107.
17. BELOUS M.V., WAYMAN C.M. Temperature Changes in Thin Metal Films during Vapor Deposition.-"J.Appl.Phys.", 1967, vol. 38, p.5119.

Поступила в ред.-изд.отд.  
24 июля 1972 г.